



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HTG-300 常规系列 【单组份导热凝胶】规格书



-产品图-

鸿富诚 **HTG-300** 系列单组份导热凝胶是一种高适配性的热界面材料，该材料具有比超软导热硅胶垫片更优越的应力应变值，可自动点胶涂覆，是多个芯片共用一个散热器/结构件场合最佳的方案选择。

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法	
颜色	粉红色	--	目视	
密度	3.2(±0.5)	g/cc	ASTM D 792	
挥发份	≤200 (@200°C24H)	PPM	GB269-85	
油离度	≤0.2 (@200°C24H)	%	SH/T0324-92	
瞬间压缩应力	< 10 (@50psi)	%	GB/T 7757-2009	
静态压缩应力	< 1 (@50psi)	%	GB/T 7757-2009	
挤出速度 @90 psi	≥15	g/min	φ2.41mmEFD注射头	
最小填充缝隙	≤0.03	mm	--	
粘接力	< 15	Psi	--	
使用温度	-50~150	°C	--	
使用面积	贮藏温度	25(6 mouths) 4(12 mouths)	°C	--
	@1 mil thickness	12.7	cm ² /g	--
	@2mil thickness	6.35	cm ² /g	--
	@5 mil thickness	2.54	cm ² /g	--
	@10 mil thickness	1.27	cm ² /g	--

应用特点：

- 高导热性能，低热阻
- 无硅油析出，无污染
- 极佳的操作性

应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 电源电阻器与底座之间
- 温度调节器与装配表面
- 热电冷却装置
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

包装：

根据不同需求，可以按照30cc/55cc/300cc等容量，按灌装包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：冷藏或阴暗处储存，

储存温度：< 25°C；

储存湿度：≤70%；

保质期：

在储存条件下：6个月

不符合储存条件下：3个月

热学特性

导热系数	3.2(±0.25)	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤0.08 (@20Psi)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ¹²	Ω·cm	ASTM D 257

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权